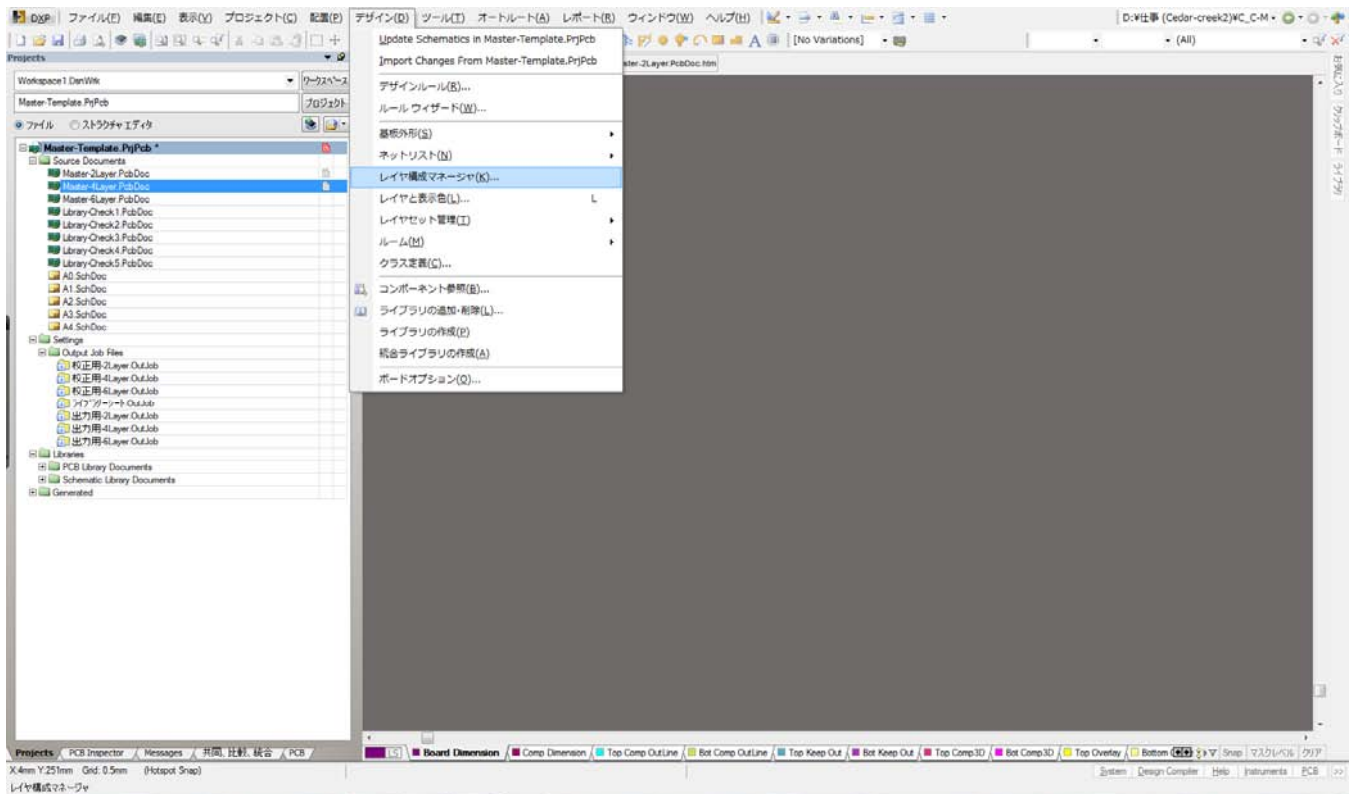
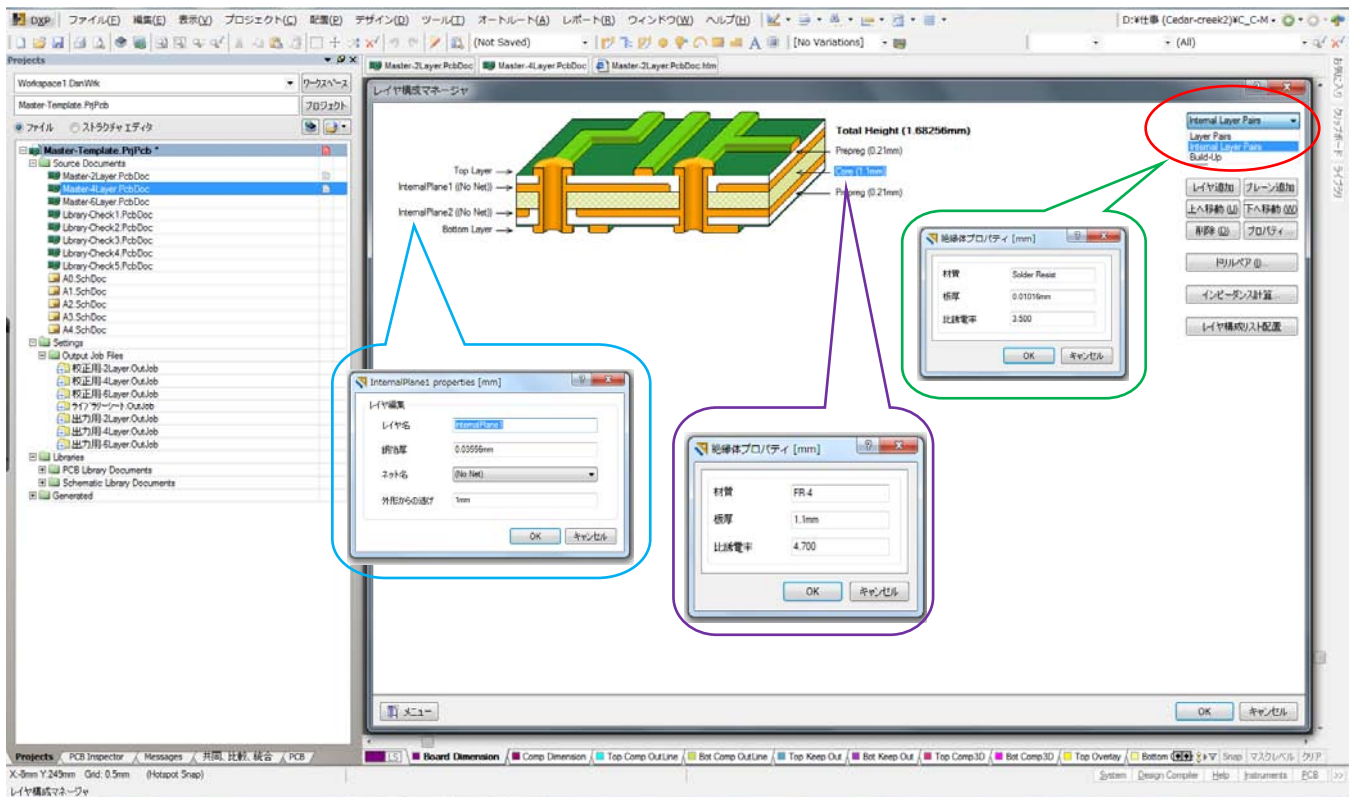


層構成

デザイン >> レイヤ構成マネージャ



レイヤ構成マネージャ (4層)



赤印：基板製造方法 1, Layer Pairs 2, Internal Layer Pairs 3, Build-Up (普通は2,)

青印：内層設定 外形からの逃げ (内層ネガ) 一般的 0.5mm~1.0mm

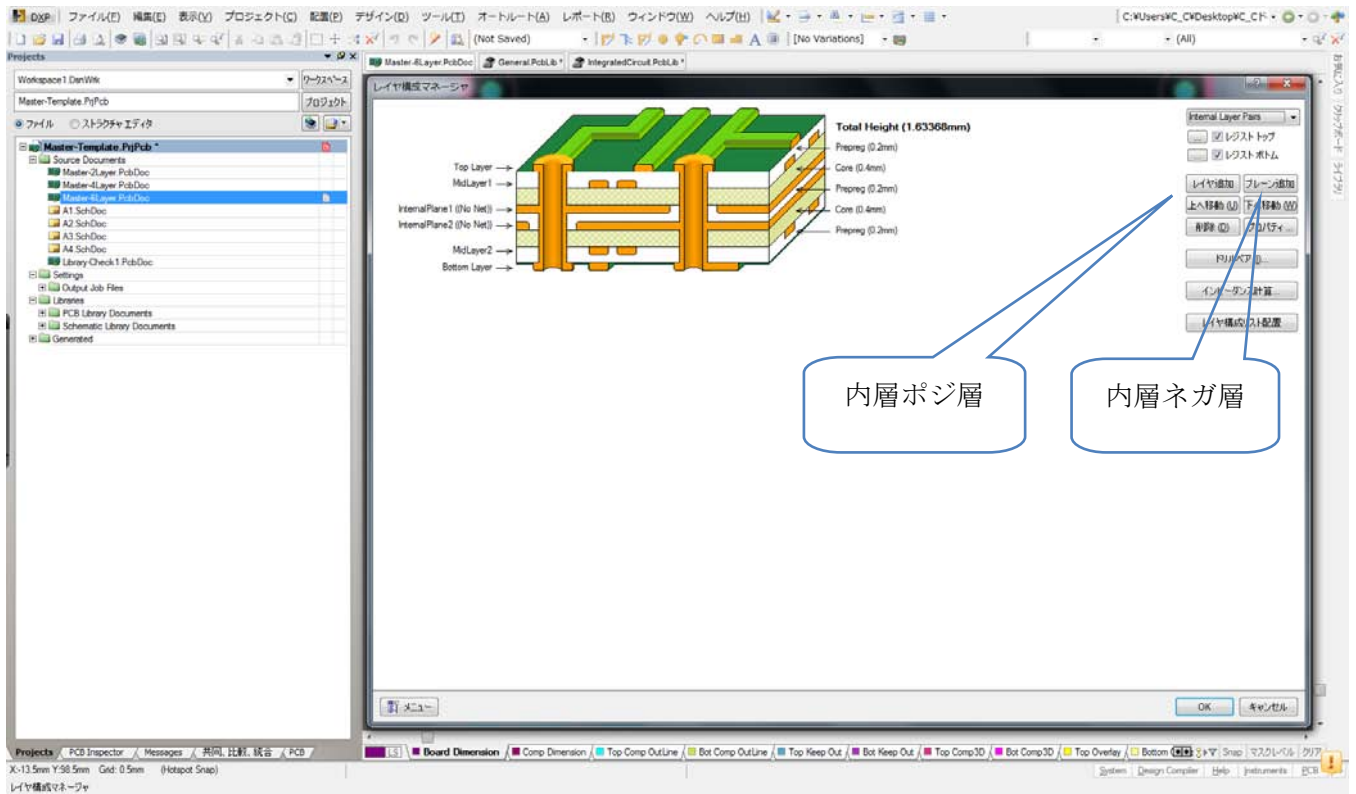
銅箔厚 (自動インピーダンス設定時に入力 一般には入力しない)

紫印：内層材質設定 板厚 比誘電率 (自動インピーダンス設定時 一般には入力しない)

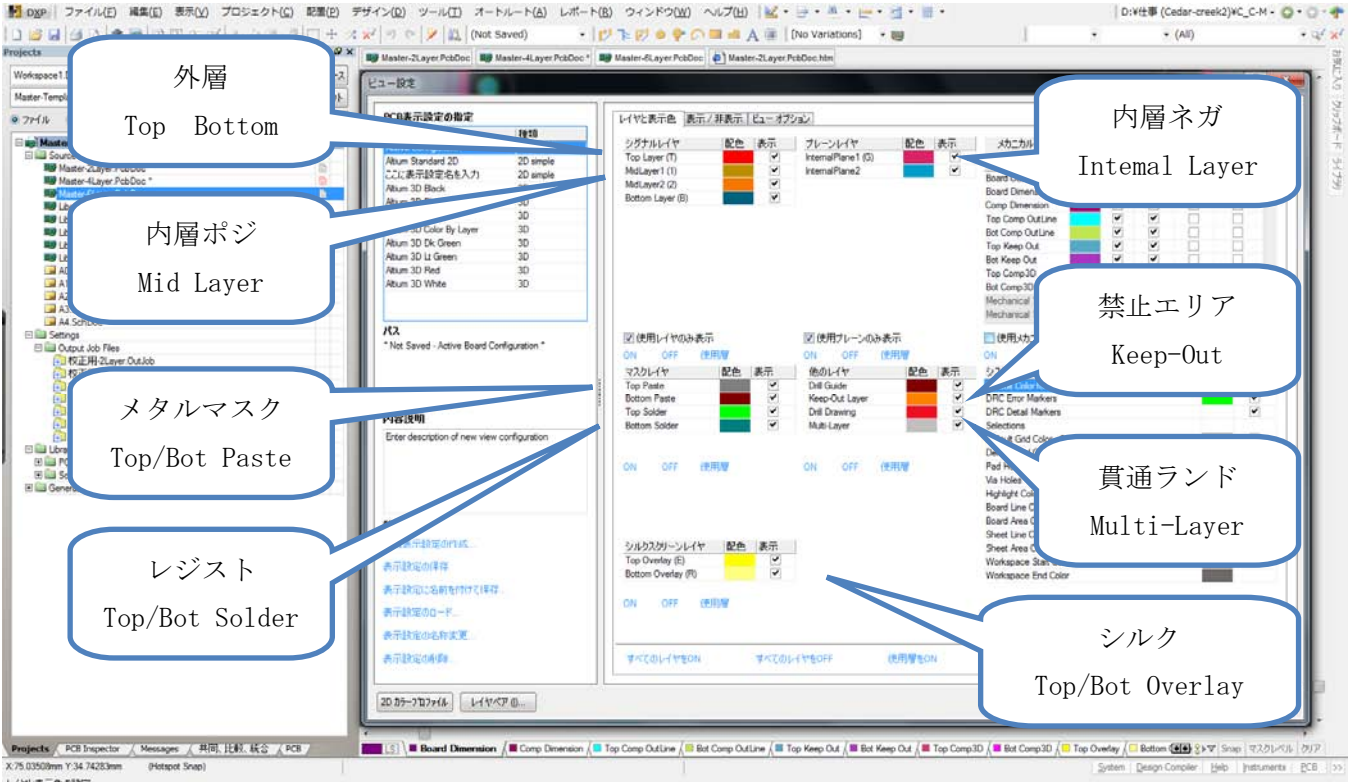
緑印：レジスト設定 材質 比誘電率 (自動インピーダンス設定時 一般には入力しない)

インピーダンスコントロールの線幅・間隔は基板製造メーカーによる。

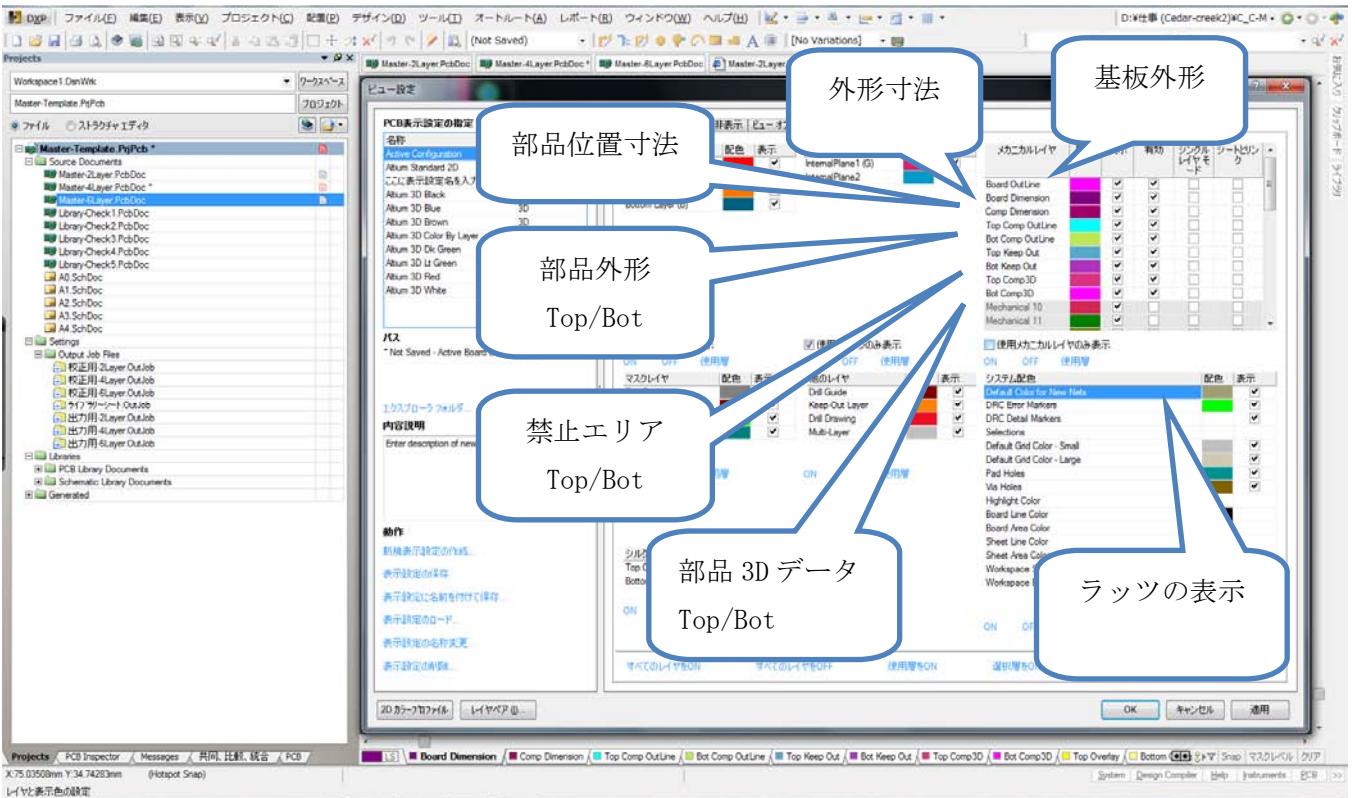
下記は6層基板



レイヤの表示設定 デザイン>>レイヤと表示色 キーボードで[L] 下記は6層



Mechanical Layer (メカニカルレイヤ) 電気的ではないデータを作成するレイヤ



Mechanical Layer の使用内容の規定はありません。ただし、Mechanical 16 は図面枠として使用します。

- Board OutLine Mechanical 1:外形
- Board Dimension Mechanical 2:寸法 (外形)      Comp Dimension Mechanical 3:寸法 (部品位置)
- Top CompOutLine Mechanical 4:部品外形枠 (部品面)      Bot CompOutLine Mechanical 5:部品外形枠 (半田面)
- Top KeepOut Mechanical 6:部品面禁止エリア      Bot KeepOut Mechanical 7:半田面禁止エリア
- Top Comp3D Mechanical 8:部品 3D データ (部品面)      Bot Comp3D Mechanical 9:部品 3D データ (半田面)